

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

紫光国芯微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20261027

投资者关系活动类别	<div>☐特定对象调研</div> <div>☐分析师会议</div> <div>☐媒体采访</div> <div>☒业绩说明会</div> <div>☐新闻发布会</div> <div>☐路演活动</div> <div>☐现场参观</div> <div>☐其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称	具体名单详见附件，排名不分先后
时间	2026 年 10 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:40
地点	线上会议：进门财经平台
上市公司接待人员姓名	董事长：陈杰 副董事长、总裁：李天池 董事、副总裁：岳超 副总裁：翟应斌 财务总监：杨秋平 董事会秘书：佟晓丹
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、公司董事会秘书介绍公司2026年第三季度经营情况（概要）</div> <div>2026年第三季度，公司持续聚焦主业、保持战略定力，加大产品研发，多措并举应对外部环境挑战，稳健夯实经营基本盘，技术持续突破开辟成长新空间；同时公司高度重视投资者回报与市值管理，推出多项举措，积极维护全体投资者利益。</div> <div>（一）经营业绩方面</div> <div>2026年前三季度，公司实现营业收入48.58亿元，营收保持平稳；归属于上市公司股东的净利润10.45亿元，同比下降17.23%，系上年第二、三季度受特殊交付因素影响，同期利润基数较高所致；经营活动现金流净额6.92亿元，同比增长142.29%，增长主要来源于特种集成电路业务销售回款流入增加。</div> <div>（二）具体业务方面</div> <div>2026年前三季度，公司持续聚焦主业，强化研发创新投入，商</div>

	<p>业航天业务已具备批量商用条件，智能安全芯片业务持续突破，同时依托中央研究院前瞻布局的端侧AI芯片、特种图像传感器CIS、二维材料半导体器件等前沿技术稳步推进，持续为公司培育新的业绩增长曲线，夯实中长期高质量发展根基。</p> <p>1. 特种集成电路业务</p> <p>研发效率持续提升，多产品布局齐头并进。作为公司核心增长极，技术迭代与商业化落地进程在持续加快。报告期内，第九代FPGA芯片已经批量供货，放量表现超预期；端侧AI芯片已向重点客户提供送样；第一代特种CIS产品已向客户送样，客户反馈良好。积极拓展宇航应用领域，构建未来增长新方向。公司已构建从工艺、设计、验证到系统级解决方案的全链条能力，可提供全流程辐照加固技术支撑，并攻关GaN星载电源技术。目前公司已形成以亿门级宇航FPGA、大容量大带宽DDR存储器、MCU等核心产品为代表的宇航领域芯片产品矩阵，达到国内领先水平，能够满足宇航领域对可靠性、成本、交付周期的多元化需求，有望为公司打开新的增量空间。</p> <p>2. 智能安全芯片业务</p> <p>公司成为中国联通eSIM卡集采赋能行动首批芯片供应商，赋能终端厂商业务发展；以核心成员身份参与中国联通AI终端新生态共创行动计划，共启数智时代新征程；同时，汽车电子业务的持续突破，可为主机厂及Tier1客户提供多种产品和解决方案的组合，进一步提升公司在汽车电子领域的综合竞争力。</p> <p>3. 石英晶体频率器件业务</p> <p>业务核心竞争力持续增强，产能基础不断夯实。在2026慕尼黑上海电子展上，公司集中展出车用电子、光模块、AI三大场景解决方案，体现全产业链自研优势与定制化配套能力。同时，超微型石英晶体谐振器生产基地建设有序推进，部分产线已转固，部分产线处于调试和建设阶段，生产能力进一步增强。</p> <p>（三）重要事项</p> <p>1. 公司积极推进瑞能半导体100%股权收购项目，已于2026年9月11日更新证券交易所《审核问询函》回复材料，目前等待证券交易所的审核意见。</p> <p>2. 基于对公司未来持续稳定发展的信心及长期投资价值的认可，8月份，公司董事、高级管理人员及相关人员共11人合计增持公司股份19.43万股；公司间接控股股东相关方智路资产增持7.94万股。</p> <p>3. 参股曲率同芯，布局高阶智驾芯片。公司以2,280万元受让曲率同芯38%股权，可有效实现公司在汽车智能化核心赛道的战略卡位，与现有的车规域控芯片、车规安全芯片等实现资源共享，提</p>
--	---

	<p>升产品转化能力。</p> <p>二、问答交流环节</p> <p>（一）发展战略方面</p> <p>1. 请问公司在当前节点，对2026全年以及未来3-5年（即“十五五”时期）有怎样的整体发展规划与展望？</p> <p>答：感谢各位投资者长期以来对公司的支持，公司对长期发展前景具备充足信心。市场较为关注公司第三季度业绩同比下滑较大，二级市场反应比较剧烈，我们理解市场的担忧，但本次业绩波动是阶段性、特殊因素导致，公司第三季度生产经营的基本面没有发生较大滑落，我们对公司当下及中长期发展依然充满信心。前段时间公司高管团队也以自有资金增持公司股份，正是基于这份信心，也请机构投资者和中小股东理性看待第三季度数据。第三季度业绩变动主要影响因素有两点：</p> <p>第一，特种集成电路业务同比回落，主要是基数效应。去年是“十四五”收官阶段，受前期交付延期影响，大量订单集中在去年三、四季度交付确认收入，使得去年第三季度基数高过正常水平；而今年是“十五五”开局之年，行业处于方案规划、新品研制阶段，需求及交付节奏有所延后，第三季度业绩只是回归常态化水平，并非公司竞争力出现根本性变化，国家层面的刚性需求没有改变。</p> <p>第二，智能安全芯片部分业务受到供应链偶发问题扰动，阶段性拖累出货，目前出货正在恢复，前期被延后的订单后续有望逐步回补。卡类芯片的长期稳定需求没有发生变化，身份证、银行卡、数字人民币、电子护照等应用场景需求持续稳健。</p> <p>关于公司中长期的发展，目前公司的特种集成电路、智能安全芯片业务构筑了稳定的基本盘，是公司发展的压舱石，为公司持续贡献稳定的现金流。公司资金储备充裕，支撑我们有序布局新赛道、培育第二增长曲线，目前新业务布局路径已经清晰，主要包括：</p> <p>第一，商业航天（低轨卫星）方向。全球低轨卫星网络建设提速，国内星网项目持续推进，能够弥补蜂窝网络覆盖盲区，催生大量应用场景。低轨空间存在辐射效应，对芯片抗辐照能力提出严苛要求，而抗辐照芯片正是公司的传统优势方向，相关产品已经批量推出。此业务增速较快，今年营业收入同比增速超50%，前三季度营业收入规模已经突破亿元，行业空间持续打开，有望保持较快增长。</p> <p>第二，面向智能汽车布局系列化车规芯片。首先是汽车安全芯片，公司已有产品大批量供货。目前公司的车规安全芯片和方案已经获得国内外头部车企认可，未来成长空间广阔。其次是高端车规级MCU，公司产品已经达到最高功能安全等级ASIL-D，可实现海外</p>
--	--

	<p>知名品牌厂商同类产品替代。考虑到车规产品安全优先的原则，前期公司审慎释放产能，优先保障可靠性；目前产品已经进入放量阶段，今年营业收入同比增速同样超过50%，长期成长潜力可观。公司已新设功率器件平台，差异化布局硅基IGBT等产品，面向新能源汽车、算力中心、工业应用等场景。同时公司新设研发主体自研自动驾驶SoC芯片，新紫光集团兄弟公司紫光展锐座舱芯片国内市占率领先，依托内部协同，公司将构建包含汽车安全芯片、高端MCU、功率器件、智驾SoC、座舱芯片在内的完整车规芯片矩阵。汽车产业体量庞大，国内新能源汽车全球竞争力突出，尽管当前行业竞争激烈，但长期仍是国内工业体系的核心支柱产业，公司致力于为国内车企提供高可靠、高性价比芯片供应商的战略决策不会动摇。</p> <p>第三，端侧AI芯片，第一代产品已经送样、小批量导入客户。工业端芯片导入周期较长，需要经过评估、测试、验证，放量尚需时间，后续我们会持续迭代优化产品。和端侧芯片配套的特种传感器研发同步推进，已与端侧芯片开展联调测试，客户试点反馈良好。</p> <p>第四，石英晶体频率器件，今年第三季度增速亮眼，持续拓展头部优质客户，在高可靠性要求的头部客户中份额超过50%。该业务虽然属于重资产业务，当前营收体量相比其他板块偏小，但属于产业链刚需环节，公司也在持续加大投入，中长期具备较好的成长空间。</p> <p>整体而言，尽管第三季度受阶段性因素影响业绩承压，但公司两大核心主业基本面稳固，持续提供稳定现金流，为新赛道研发、产业化投入提供支撑。我们在商业航天（低轨卫星）、智能汽车、端侧AI与特种传感器、石英晶体频率器件等方向的布局有序落地、进展顺利。公司的发展逻辑，就是依靠多年构筑的高可靠、高安全技术能力，输出差异化方案，服务上述高成长性赛道。</p> <p>2. 市场比较关注公司特种集成电路、智能安全芯片业务中长期增长的确定性。请介绍，未来半年至一年，哪些业务板块能够对收入和利润形成较强拉动？能否相对量化介绍对应赛道的市场空间，以及公司预期市占率情况？</p> <p>答：若公司收购瑞能半导股权完成后，将形成四大主要板块，包括特种集成电路业务、智能安全芯片业务、石英晶体频率器件业务以及功率器件业务。特种集成电路业务主要分为传统特种业务、商业航天、民用航空三大领域；智能安全芯片业务主要分为安全芯片、汽车电子芯片等。石英晶体频率器件业务包括振荡器、谐振器。</p> <p>公司的中长期规划方面，特种集成电路业务希望保住基本盘、</p>
--	---

	<p>实现稳中有升，增量重点在商业航天；民用航空基数较小，将随国产大飞机市场发展具备增长潜力；智能安全芯片业务在汽车电子MCU、自动驾驶等业务已布局、客户导入顺利，是明显的增量来源；石英晶体频率器件业务方面，高端振荡器在部分高要求客户中市占率已超过50%，未来增长会很明显；功率器件业务方面，收购落地后，目标在营收与利润上对公司形成明显贡献。</p> <p>（二）特种集成电路业务方面</p> <p>3. 公司此前表示，未来希望商业航天收入在特种集成电路业务收入中的占比逐步提升至3%-5%，请介绍目前该领域客户拓展及在手订单情况如何？</p> <p>答：在商业航天领域，公司已完成产品布局。随着国网一代、二代卫星密集发射，相关业务增量将逐步释放。前三季度公司的商业航天业务营业收入已突破亿元，3%的收入占比目标已经达成，未来希望持续增长。</p> <p>4. 公司之前交流曾提到，端侧AI芯片正在向无人机场景渗透，客户已经开始试用，此前预期2026年底至2027年有望实现小批量放量。想了解当前客户试用进展，以及公司对明年端侧AI芯片业务的预期？</p> <p>答：公司在端侧AI布局已有两年，相关成果目前正处于客户试用导入阶段，包括特种图像传感器CIS芯片也在客户试用导入中。客户试用导入周期较长，且客户需求持续变化，公司同步适配需求。同时，公司同步启动第二轮芯片迭代研发，迭代版芯片预计明年推出，但落地节奏仍取决于客户需求，暂无法给出明确放量时间表。公司端侧AI主要用于无人机等终端设备的视觉图像智能处理。</p> <p>5. 子公司深圳国微作为公司营收、利润的核心基本盘，其前三季度营收和利润的情况如何？今年三季度单独的营收、利润概况如何？并展望其特种业务订单走势。</p> <p>答：深圳国微经营情况符合行业的总体水平。特种领域板块，前三季度稳中有升，第三季度单季利润同比下滑属于行业特殊因素影响（第1问答复中已介绍原因）。商业航天业务已形成增量，FPGA、存储等产品持续供货，宇航领域芯片产品矩阵已达到国内领先水平，随着国内卫星互联网的发展，未来会逐渐释放增量。在稳中有升的基础上，公司对完成全年的任务充满信心。</p> <p>6. 基于深圳国微特种领域在手订单，如何展望后续季度经营面貌？如何看待特种行业“十五五”规划，以及2027年集成电路相关产品的订单趋势？</p> <p>答：2025年作为“十四五”收官之年，特种行业订单规模呈现阶段性的脉冲增长；2026年订单基本正常，从四季度公司已经开始</p>
--	--

	<p>为明年进行备货，目前看情况比较乐观。2027年为“十五五”第二年，特种领域需求预计增长，行业长期发展潜力较大。深圳国微会全力做好基本盘，同时抓住国家商业航天低轨卫星互联网发展的一个契机。另外就是民用航空市场也在布局公司的货架产品，包括一些新业务的积淀，也在逐渐推进，力争整体稳中有升。</p> <p>7. 四季度以来特种领域订单环比是保持平稳还是什么趋势？四季度或者明年一季度“十五五”规划落地时，特种相关订单是否有望看到比较显著的上升？</p> <p>答：目前看，四季度订单情况平稳。明年订单要到一季度才能看得更清楚，预计一季度末期才会比较明朗。</p> <p>8. 商业航天领域新增订单情况以及在前三季度营业收入中的占比大概是多少？单独看该板块，订单的同环比增长态势如何？</p> <p>答：各机构比较关注公司的技术产品能力与供货保障能力，在商业航天领域，与FPGA配套的回读刷新芯片、总线、电源等新品在陆续推出；产品已在国网一代使用，国网二代的相关产品正在做方案，力争未来给公司带来较大的增量。国网万颗卫星布局尚有较大空间，但后续增量也取决于卫星互联网建设进度。</p> <p>9. 深圳国微特种领域产品的价格走势以及盈利水平较去年同期的变化情况。</p> <p>答：特种行业走势“两高一低”，即高质量、高效益、低成本，产品价格大趋势是整体下行。公司一方面做好成本管控，另一方面调整产品结构，推出RF-FPGA、RF-SOC、MCU等高价值、高毛利产品，对冲行业产品价格下行带来的影响。深圳国微特种业务毛利率比较稳定，前三季度盈利水平基本正常。</p> <p>（三）智能安全芯片业务方面</p> <p>10. 公司第三季度收入较第二季度减少约4亿元，第三季度特种集成电路业务收入与第二季度基本持平、略有下滑，差距主要在智能安全芯片业务，系公司调整产品出货节奏所致。请问第四季度智能安全芯片业务缺口能否有较好体现，利润能否好于前三季度，对标去年二、三季度利润高点？</p> <p>答：从订单情况看，公司智能安全芯片业务正逐步改善，因调整产品结构，第四季度预计好于第三季度，但业绩具体体现时点将根据市场情况判断。</p> <p>11. 目前智能安全芯片业务发货节奏的调整，是产能端受限，还是存货端储备较为充足、为最大化利用现有产品而主动作出的安排？</p> <p>答：因制造端产能总体紧张，货源不及正常时期充裕，需要仔细权衡出货策略。</p>
--	---

12. 子公司同芯微今年三季度营收、利润的情况如何？四季度出货的情况？同芯微全年以及明年的发展趋势如何？

答：同芯微三季度各产品线订单均高速增长，影响业绩的原因主要有两点：一是产品结构做了调整，二是产能紧张带来的影响。考虑到行业进入上行周期，对于公司整体发展我们还是充满信心。

13. 公司车规级MCU芯片已获得宁德时代等头部客户百万级订单，三季度以来的进展以及全年预计营收规模如何？

答：去年公司与宁德时代成立了合资公司，决策非常正确，公司已经在宁德时代获得充足订单。三季度公司车规级芯片推进较快，除宁德时代外，MCU芯片今年已面向多领域客户全面量产。

14. 公司今年9月披露了《关于全资子公司与关联方共同购买股权暨关联交易的议案》，如何理解和评估曲率同芯在车载自动驾驶AI芯片这个领域当中目前的竞争态势？

答：公司进入智驾领域的原因有两点：一是行业是否有新的需求和新的变化，二是行业发展变化是否顺应技术发展，这是公司的切入点。未来两三年智驾行业将会发生巨变，L3、L4已经在逐步落地，对算力的要求更高，技术将会迅速演进；同时存储缺货提升了车厂对于舱驾一体的关注度。

公司切入该赛道具备很多优势：第一是客户资源，公司的MCU产品已经导入国内大部分车企，拥有天然的客户资源；第二是公司可以使用业内最先进的车规工艺；第三是公司能与新紫光集团内有座舱开发能力的紫光展锐进行业务协同，由公司主导智驾芯片、展锐配套座舱能力。

目前智驾芯片项目推进顺利，头部车企合作意向强烈，我们对智驾业务前景及发展充满信心。

（四）财务方面

15. 公司前三季度整体毛利率略有下滑；预付账款较年初增长43%，主要系预付晶圆采购款增加。请介绍当前公司成本管控情况如何？对全年毛利率会带来怎样的影响？

答：公司前三季度毛利率确实存在小幅下滑。一方面，公司智能安全芯片业务产品结构调整，对毛利率形成影响；另一方面，今年上游制造端成本上升，相应成本压力向下游传到存在时间上的迟滞。公司通过集中采购、内部信息化管理等降本措施加以应对，效果较好，毛利率呈缓慢下行而非断崖式下降，以内部措施和产品结构优化对冲市场竞争带来的价格下行压力。

16. 公司经营性现金流持续改善、回款增加，应收账款环比也没有大幅抬升，但信用减值损失反而有所增加，请问背后是什么原因，后续是否还有进一步计提压力？

	<p>答：公司前三季度信用减值损失约9,900余万元，主要来自特种集成电路业务的计提。特种业务客户结算特点是集中在年末回款，影响9-10月应收账款规模一般高于年末水平，因此三季度计提坏账规模偏高。特种行业客户资质信誉很好，历史上几乎无坏账发生。待到年末集中回款后，信用减值计提会有所减少。公司始终坚持财务审慎原则，今年经营活动现金流状况良好。</p> <p>17. 当前半导体行业处于涨价周期，理论上存货价值应该上行，但公司存货跌价损失也出现明显增加，请介绍，公司存货减值增加的原因是什么？</p> <p>答：存货减值损失主要是特种集成电路业务常态化管理形成。公司为保障产品质量，定期对待处置仓进行清查盘点，对测试后确认无法保质供货的产品计提存货跌价准备，属于公司日常的管理举措。公司特种业务营业收入体量较大，本次减值对应的存货是多年逐步累积形成。公司结合客户情况在前三季度集中处理，基本已处理大部分，后续不排除仍有个别计提，整体数量可控。</p> <p>（五）其他方面</p> <p>18. 公司去年推出股权激励方案，按方案，若达成75%行权比例对应的考核目标，今年利润相对2024年增速区间为30%-60%；按30%下限测算，利润规模约15亿元。市场在三季报披露后存在短期担忧，结合管理层刚刚介绍，理解为偶发性因素导致。请介绍，对于股权激励75%行权比例对应的考核目标，目前如何展望今年及明年股权激励行权达成情况？</p> <p>答：公司股权激励第二个行权期设置了四档行权比例：0%、50%、75%、100%。目前公司正在全力冲刺2026年度考核目标，100%行权比例对应的考核目标达成存在较大挑战。公司将围绕主要业务板块、投资收益、市场推广、新产品研发、生产保障及增量业务等全面努力，争取最好结果，按照既定目标努力完成。</p> <p>19. 公司是否后续有可能下调可转债的转股价格？</p> <p>答：公司可转债在明年6月份到期，公司希望债权人优先选择债转股，当前转债价格97元/股左右，若临近到期股价与转债价差较大，公司会考虑下修转股价，下修会综合考虑行业发展情况、经营情况、资本市场走势等因素审慎决策，但现阶段不是合适的下修时点。如债权人拟到期兑付，公司也有充足的资金用于支付。</p> <p>20. 公司正在收购瑞能半导，除此之外，在外延发展这块后续还有哪些规划？</p> <p>答：瑞能半导的产品及技术已有几十年的积累，特别是在欧洲、日本等地产品得到好评，产品品质稳定。投产初期受新产线设备折旧影响业绩短期下滑。收购完成后，公司一方面赋能瑞能半导，</p>
--	---

	<p>巩固现有业务、增强竞争力，利用几十年的积累开拓新产品；另一方面利用好在建的IDM工厂的产能，做好产品规划。</p> <p>此外，公司在持续开拓新的业务，推出一系列面向AI算力中心的产品。这些产品一部分由瑞能半导负责，另外一部分由公司专门做功率器件设计公司负责。此功率器件设计公司主要做比较高端、量大的功率器件，包括数据中心、汽车电子等方面的器件。</p> <p>三、结束语</p> <p>感谢线上及现场各位机构投资者的参会，后续公司将持续聚焦主业，保持行业龙头地位，继续加大研发投入，稳步优化生产经营各项工作。尽管第三季度业绩同比有所下滑，但公司已落地多项应对举措，叠加多款新产品逐步推进，后续经营有望改善、实现更好的表现。</p> <p>感谢各投资机构、各股东持续信任和支持紫光国微！</p>
附件清单(如有)	除《参会名单》外，无其他附件。
日期	2026 年 10 月 27 日

附件:参会名单 (排名不分先后)

序号	机构名称/自然人姓名
1	Dymon Asia Capital (HK) Limited
2	百年保险资产管理有限责任公司
3	北京盛曦投资管理有限责任公司
4	北京天九投资有限公司
5	贝莱德集团
6	财通证券股份有限公司
7	财信基金管理有限公司
8	德邦证券股份有限公司
9	东方财富证券股份有限公司
10	东吴证券股份有限公司
11	方正证券股份有限公司
12	光大证券股份有限公司
13	广东正圆私募基金管理有限公司
14	广发证券股份有限公司
15	国海证券股份有限公司
16	国金基金管理有限公司
17	国金证券股份有限公司
18	国联安基金管理有限公司
19	国泰基金管理有限公司
20	海通国际研究有限公司
21	恒安标准人寿保险有限公司
22	华创证券有限责任公司
23	华福证券股份有限公司
24	华润元大基金管理有限公司
25	华泰证券股份有限公司
26	华西证券股份有限公司
27	华夏基金管理有限公司
28	华源证券股份有限公司
29	汇泉基金管理有限公司
30	嘉实基金管理有限公司
31	江信基金管理有限公司
32	金泰银安新能(北京)科技有限公司
33	蓝海启程(北京)投资管理有限公司
34	曼林(山东)私募(投资)基金管理有限公司
35	美银证券有限公司
36	摩根士丹利亚洲有限公司
37	南方基金管理股份有限公司
38	鹏华基金管理有限公司
39	淇琳投资
40	瑞圣源(上海)私募基金管理有限公司
41	瑞众人寿保险有限责任公司

序号	机构名称/自然人姓名
42	山西证券股份有限公司
43	上海东方证券资产管理有限公司
44	上海方物私募基金管理有限公司
45	上海景林资产管理有限公司
46	上海泉上投资管理有限公司
47	上海申银万国证券研究所有限公司
48	上海益和源资产管理有限公司
49	上海重阳投资管理股份有限公司
50	深圳丞毅投资有限公司
51	深圳进门财经科技股份有限公司
52	深圳荣升资产管理有限公司
53	深圳市凯丰投资管理有限公司
54	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
55	天风(上海)证券资产管理有限公司
56	天弘基金管理有限公司
57	新华资产管理股份有限公司
58	新紫光集团有限公司
59	兴业证券股份有限公司
60	圆信永丰基金管理有限公司
61	远信(珠海)私募基金管理有限公司
62	长城证券股份有限公司
63	长江证券股份有限公司
64	浙商证券股份有限公司
65	中国国际金融股份有限公司
66	中国人寿资产管理有限公司
67	中国银河证券股份有限公司
68	中航信托股份有限公司
69	中汇人寿保险股份有限公司
70	中泰证券(上海)资产管理有限公司
71	中泰证券股份有限公司
72	中信期货有限公司
73	中信证券股份有限公司
74	中意资产管理有限责任公司
75	中银基金管理有限公司
76	中邮证券有限责任公司
77	众盈基金管理有限公司